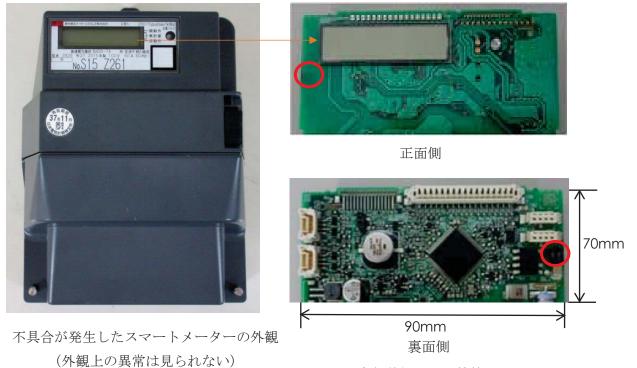
## 不具合の概要

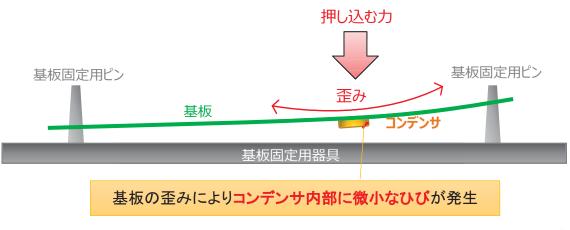
## <不具合の内容>



内部基板及び発熱箇所

## <不具合の原因>

製造工程において基板を固定する際、基板に歪みが生じ、電子部品(コンデンサ)内部にひびが発生し、経年により故障に至った。



以 上